

『機械要素技術展』 出展のご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、モリテックスでは2023年6月21日（水）～23日（金）まで東京ビッグサイトにて開催されます「第28回 機械要素技術展」に、**米国 Bal Seal Engineering社製品**を出展致します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具



Bal Seal

PTFEまたはポリエチレンをベースにしたジャケット材にスプリング弾性を持たせたカスタムシールです。**低摺動抵抗**で**長寿命**のシールを個別の用途に最適化した設計でご提供します。

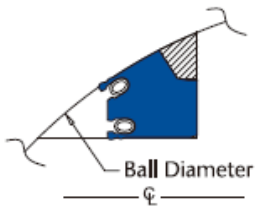


Bal Spring

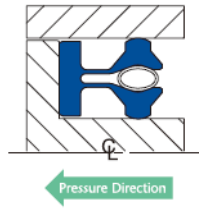
斜め巻きコイルスプリングにより、差し込むだけの**容易な脱着機構**をご提案します。

ご希望に応じた抜去力の設定や**ロック機構**の構築も可能です。

また、多点接続を約束する**電気接点**としてのご用途もございます。



ボールバルブ用シール



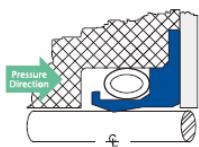
低摺動抵抗シール



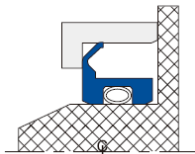
Bal Springによる脱着・ロック機構



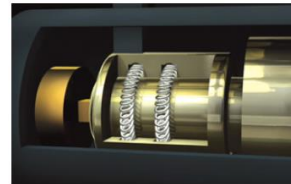
ボールジョイントの接続機構



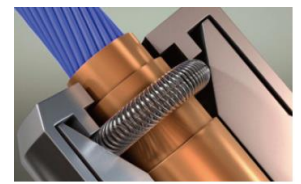
極低温用シール



高速回転用シール



多点接続電気接点
(内径φ0.7mm～)



EMIシールド・グランド
用途例

第28回 機械要素技術展 M-Tech

会期：2023年6月21日（水）～23日（金） 会場：東京ビッグサイト

2023年6月21日（水）～23日（金）
東京ビッグサイト

小間番号：64-49（7ホール）